

切削用素材「セミロン[®] MP370」を発売
～セラミック充填の変性 PEEK 樹脂を使用～

クオドラント ポリペンコ ジャパン株式会社

クオドラント ポリペンコ ジャパン株式会社(本社:東京都中央区 社長:尾石 茂也)は、より微細な形状の切削が求められる半導体検査工程のテストソケット等の用途に、セラミックを変性 PEEK 樹脂に充填し、高精度と良好な切削加工性を両立させた切削用素材、「セミロン[®] MP370」の本格販売を2012年初頭から開始します。

半導体の後工程と呼ばれる検査工程では、テスターを用いて各 IC チップの測定および検査を行います。IC チップの全ての電極を、テスター上にセットされたテストソケットのプローブピンに接触させ、低温から高温まで様々なテスト条件で製品規格を満たすかを確認し、合否を判定します。テストソケットには高い剛性、寸法安定性、耐熱性などが求められ、PI、PAI 及び PEEK 樹脂等の切削用素材が使用されています。

近年、自動車や携帯電話などに多用される IC チップは、小型化が求められる一方、扱う情報量が増加しています。それに伴い、テストソケットのプローブピン数も増加し、ピッチも 0.2mm～0.3mm とさらに微細になっているため、最先端のテストソケット向けに使用される切削用素材には、さらなる高精度な加工が可能でバリが少ないなどの切削性向上が求められています。

そこで、当社は、クオドラントグループが米国で開発した「セミロン[®] MP370」を、アジア地域で高まる顧客のニーズと、先行する米国での販売実績を背景に、半導体検査工程のテストソケット向けに輸入販売します。この切削用素材は、改良した変性 PEEK 樹脂を主原料に、セラミックが均一に高充填されているため、切削時にバリの発生が少ない上、高精度の切削加工が可能のため、テストソケット上の穴の位置精度が安定します。さらに、変性 PEEK 樹脂は、吸水率が低く熱膨張も小さいため、IC チップのテスト条件下で寸法安定性も優れています。変性 PEEK 樹脂はガラス転移点*が160℃と PEEK 樹脂(同140℃)より高く、通常より条件の厳しい車載 IC チップで要求される150℃にも対応します。

当初販売する素材は、厚み6mm、9mm、12mmの板材を予定しており、すでにサンプリングを開始しています。

当社は、2011年12月7日から開催されるセミコン・ジャパン2011に出展するなど、テストソケットメーカーを中心に「セミロン[®] MP370」のマーケティング活動を実施し、来年初頭から本格的な販売を開始します。

* ガラス転移点: 高分子が、軟らかい状態から固い状態、もしくはその逆になる温度

＜本件に関する報道関係のお問合せ先＞
クオドラント ポリペンコ ジャパン株式会社
市場開拓部
TEL:03-3279-3207

<資料>

【クオドラント ポリペンコ ジャパン株式会社 概要】

本社所在地 : 東京都中央区日本橋本石町 1-2-2 三菱樹脂ビル

資本金 : 240百万円

出資比率 : 三菱樹脂 38%

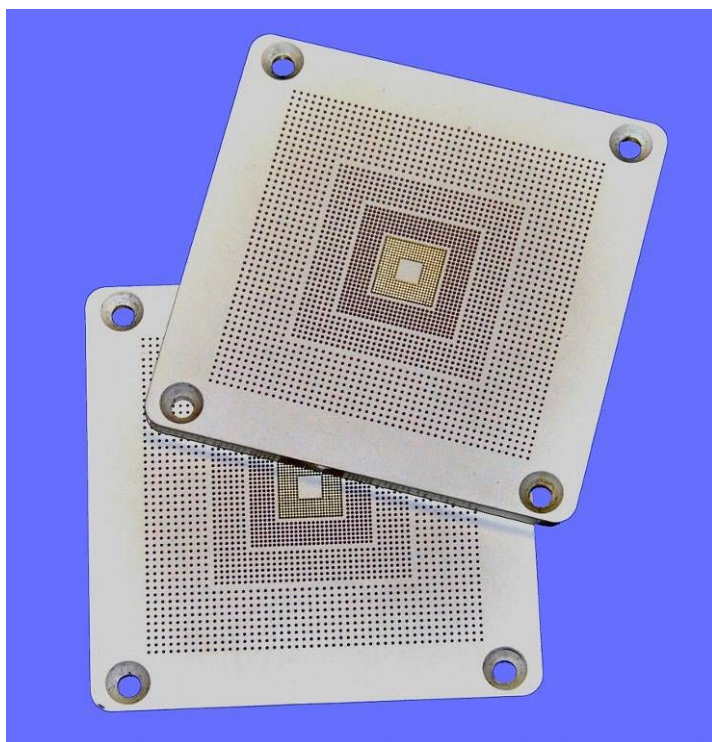
クオドラントグループ(3社) 62%

売上高 : 約70億円

事業内容 : エンジニアリングプラスチック製品の製造・販売

営業拠点 : 東京、大阪、名古屋、福岡、広島

【製品写真】



「セミロン[®] MP370」の切削加工例